

合肥市发展和改革委员会 合肥市财政局文件

合发改高技〔2022〕620号

合肥市发展改革委合肥市财政局关于印发 合肥市加快推进集成电路产业发展 若干政策实施细则的通知

各县（市）区发改委、财政局，开发区经贸局、财政局：

现将《合肥市加快推进集成电路产业发展若干政策实施细则》印发给你们，请遵照执行。

合肥市发展和改革委员会



合肥市财政局

2022年6月8日



合肥市发展和改革委员会办公室

2022年6月8日印发

合肥市加快推进集成电路产业发展 若干政策实施细则

为贯彻落实《合肥市加快推进集成电路产业发展若干政策（合政办〔2022〕18号）文件精神，规范集成电路产业政策资金申请及管理，特制定本实施细则。

一、申报主体

本政策适用于在合肥市行政区划内完成工商、税务登记并实际经营，从事集成电路设计、制造、封装测试、设备材料、EDA、IP、传感器、模组、公共服务等领域研发、生产和服务的独立法人单位和与之相关的公共平台、创新载体配套服务机构及终端应用企业等。具有失信行为信息（有效期内）的企业、单位、个人等不享受政策支持。

二、申报、审核及兑现程序

（一）申报时间

申报时间以市发改委官网和合肥市产业政策管理信息系统中发布的通知为准。申报截止期限遇节假日顺延，逾期没有申报，视为自动放弃，将不再受理。

（二）申报方法

申报主体首先登录合肥市产业政策管理信息系统（<http://61.133.142.83/hfczxm/public/cyzcw/login>），并录入真实完整信息，完成注册；其次对照自身经济类型及发展实际，订阅相

关政策条款，并仔细阅读实施细则和相关资金管理办法，提前做好申报准备工作；再次是关注具体申报通知要求，及时在网上提交真实、完整的申报材料，并关注部门初审意见，及时完善申报材料。原则上只上门报送材料一次。

各县（市）区、开发区主管部门需在产业政策管理信息系统内完成企业申报材料的审核。

（三）兑现流程

1.组织评审。市发改委开展审核，必要时可委托第三方机构或组织相关专家进行审核，根据审核情况抽取部分企业进行现场核查，最终出具评审意见。

2.开展联合会审。市发展改革委牵头会同市科技局、市经信局、市财政局、市投促局等部门组成联合会审小组，参照《合肥市推动经济高质量发展政策联合审核导则》要求，对评审意见进行会审并形成意见。

3.拟定资金方案。市发展改革委依据评审意见，结合联合会审意见，提出资金安排方案。

4.结果公示。资金安排方案通过市发改委网站、市产业政策管理信息系统和《合肥日报》等平台向社会公示，公示内容包括申报单位名称、对应条款等，公示期5天。

5.资金下达。经公示无异议后，报市政府审批，经市政府批准后，市发展改革委印发资金计划，市财政局将政策资金预算拨付至市直部门或下达有关县（市）区、开发区财政局，由其拨付至相关项目单位。

二、申报条件和申报材料

申报各条款均须提供：

- (1) 合肥市集成电路产业政策资金申请表（见附件 1）；
- (2) 加载统一社会信用代码的营业执照复印件（名称变更的提供变更核准通知书）；
- (3) 企业在国家、省、市信用系统内无失信行为记录证明；
- (4) 合肥市集成电路政策申请诚实信用承诺书（见附件 2）。

申报材料涉及增值税发票的，专票提供抵扣联，普票提供发票联。通过纸质承兑汇票付款的提供供货方收据，电子承兑汇票付款的提供供货方收据或银行签章。在兑付过程中确需但细则中未列明的申报材料，需由申报主体在 3 个工作日内提供。

（一）支持企业流片。

1. 申报条件：

- (1) 设计企业、高校院所对拥有自主知识产权产品开展多项目晶圆（MPW）流片；
- (2) 设计企业对拥有自主知识产权产品开展首次全掩膜（Full Mask）工程流片。

2. 申报材料：

- (1) 流片补贴申报明细表（见附件 4）；
- (2) MPW、Full Mask 情况说明，介绍产品主要功能及用途、技术指标及先进性、与公司其他相关产品的差异说明等；
- (3) 与晶圆代工厂直接签订流片合同，或通过相关国家“芯火”双创基地委托代理流片，或通过晶圆代工厂指定代理机构流

片的，提供合同、银行付款凭证、增值税发票等相关材料；其中与境外晶圆代工厂（或境外代理公司）签订流片合同的，须提供合同、形式发票、银行付款凭证、海关报关单（未报关的提供芯片销售合同等佐证材料）及以上材料主要内容翻译成中文的相关材料；

（4）其它形式的流片（非上述（3）规定的直接或委托代理流片方式），除提供上述佐证资料外，还需提供代理中介公司至晶圆代工厂交易的全过程合同、银行付款凭证、增值税发票等相关资料。

3.支持方式：

（1）经认定，多项目晶圆（MPW）流片，按照流片费用70%给予补助，年度补助总额最高300万元（高校院所最高150万元）。

（2）经认定，首次全掩膜（Full Mask）工程流片，按照掩模版制作费用50%给予补助，其中对工艺制程大于28nm的，年度补助总额最高300万元；对工艺制程小于等于28nm的，年度补助总额最高800万元。

（3）每家企业年度补助总额最高1000万元。

（二）支持企业购买和研发IP。

申报类别 1

1.申报条件：

（1）企业向IP提供商购买IP（含Foundry IP模块）用于研发活动；

(2) 企业向本地第三方机构购买 IP 用于研发活动。

2. 申报材料:

(1) IP 补贴申报明细表 (见附件 5);

(2) 购置 IP 情况说明, 介绍 IP 功能、用途、授权期限及主要用于的研发芯片产品等;

(3) 购买 IP 的相关合同、银行付款凭证、增值税发票、License agreement (许可证协议) 等; 直接从境外购买 IP 的提供合同、形式发票、银行付款凭证、海关报关单及以上材料主要内容翻译成中文的相关材料; IP 用于工艺制程小于等于 28nm 研发的, 原则上提供流片光罩合同等相关证明材料。

3. 支持方式:

(1) 经认定, 按照向 IP 提供商 (含 Foundry IP 模块) 购买 IP 实际发生费用 40% 给予补助, 其中对工艺制程大于 28nm 的, 年度补助总额最高 300 万元; 对工艺制程小于等于 28nm 的, 年度补助总额最高 500 万元;

(2) 经认定, 按照向本地第三方机构购买 IP 实际发生费用 40% 补助, 每家企业年度补助总额最高 100 万元。

申报类别 2

1. 申报条件:

企业在合肥从事集成电路 IP 研发并产生研发费用 (年度企业 IP 营业额占比超 50%)。

2. 申报材料:

(1) 研发 IP 补贴申报明细表 (见附件 6);

(2) 企业研发 IP 情况说明，介绍企业相关 IP 产品研发情况及企业 IP 营收情况；

(3) 会计师（审计师）事务所关于开发 IP 研发投入费用的专项审计报告（审计报告需列出研发投入资金明细、发票号等关键信息）及相关的合同或协议、设备或物资采购发票、付款凭证和企业所得税年度纳税申报表等。

3.支持方式:

经认定，按照 IP 研发年度投入 15%进行补助，每家企业年度补助总额最高 1000 万元。

(三) 支持企业购买、租用和研发 EDA 工具软件。

申报类别 1

1.申报条件:

(1) 集成电路企业购买 EDA 工具软件(含软件升级费用)用于研发生产活动；

(2)企业租用本地集成电路公共服务平台 EDA 工具软件用于研发生产活动。

2.申报材料:

(1) 购买或租用 EDA 补贴申报明细表（见附件 7）；

(2) 购买或租用 EDA 情况说明，介绍 EDA 功能、用途、授权期限及主要用于的研发生产产品等；

(3) 购买或租用 EDA 相关合同、银行付款凭证、增值税发票、EDA 提供商授权合同等；直接从境外购买 EDA 的提供合同、形式发票、银行付款凭证、海关报关单及以上材料主要内容翻译

成中文的相关材料。

3.支持方式:

(1) 按照购买 EDA 工具软件实际发生费用 50%给予补助,每家企业年度补助总额最高 200 万元;

(2)按照租用本地集成电路公共服务平台 EDA 工具软件实际发生费用 50%给予补助,每家企业年度补助总额最高 100 万元。

申报类别 2

1.申报条件:

企业在合肥从事集成电路 EDA 工具研发并产生研发费用。

2.申报材料:

(1) 研发 EDA 补贴申报明细表 (见附件 8);

(2) 企业研发 EDA 情况说明,介绍企业相关 EDA 产品研发情况;

(3) 会计师(审计师)事务所关于开发 EDA 研发投入费用的专项审计报告(审计报告需明确研发投入资金明细、发票号等关键信息)及相关的合同或协议、设备或物资采购发票、付款凭证、企业所得税年度纳税申报表等。

3.支持方式:

经认定,按照 EDA 研发年度投入 30%进行补助,每家企业年度补助总额最高 2000 万元。

(四) 支持半导体 IDM 企业开发新产品。

1.申报条件:

半导体 IDM 企业开发的半导体产品经省市主管部门认定为

新产品。

2.申报材料:

- (1) 开发新产品奖励申报明细表(见附件9);
- (2) 省市主管部门认定半导体新产品的相关文件证明材料。

3.支持方式:

每开发一种新产品奖励50万元。每家企业年度奖励总额最高300万元。

(五) 支持企业加大投资。

1.申报条件:

(1) 总投资3亿元以上的集成电路制造、封测类项目,总投资5000万元以上的集成电路装备、材料类项目,设备总投资1000万元以上的集成电路设计企业项目。固定资产投资包括洁净间、研发和生产设备(含支撑设备运行软件)、研发和生产线上检测设备和环保设备等;

(2) 已形成实物工作量的在建固定资产投资项目,且须自申报年度起3年内完成总投资,由县(市)区、开发区主管部门组织验收并向市发改委报备;

(3) 项目单位应具备实施该项目的资金、技术等相关能力。

2.申报材料:

- (1) 固定资产投资补贴申报明细表(见附件10);
- (2) 项目备案文件;
- (3) 购置设备的情况说明,介绍设备功能、用途等相关情况;

(4) 购置设备的合同、银行付款凭证、增值税发票、设备铭牌照片等；其中购置进口设备的补充提供银行付汇凭证及报关单及以上材料主要内容翻译成中文的相关材料；购置融资租赁设备的补充提供与融资租赁公司签订的协议、融资租赁公司开具的增值税发票；申请洁净间补助的须待洁净间建设完成，提供洁净间工程造价预算、专项审计报告以及工程决算报告(或相关验收材料)等。原则上补助 2021 年 1 月 1 日后备案的项目。

3.支持方式:

经认定，按照固定资产实际投资额（含洁净间建设费用，不含土地购买和厂房建设费用）15%给予补助，每家企业补助总额最高 2000 万元。

(六) 支持企业成长壮大。

申报类别 1

1.申报条件:

年度销售收入首次突破 5000 万元、1 亿元、3 亿元、5 亿元、10 亿元、20 亿元的集成电路设计（含 EDA、IP，下同）、第三方服务平台以及装备、材料、智能传感器和模组制造类企业。

2.申报材料:

(1) 企业成长壮大奖励申报明细表（见附件 11）;

(2) 经审计的年度企业财务审计报告、企业所得税年度纳税申报表等相关证明营收材料。

3.支持方式:

对年度销售收入首次突破 5000 万元、1 亿元、3 亿元、5 亿元、10 亿元、20 亿元的集成电路设计（含 EDA、IP，下同）、第三方服务平台以及装备、材料、智能传感器和模组制造类企业，分别给予企业 50 万元、100 万元、150 万元、200 万元、300 万元、500 万元一次性奖励。上述资金企业奖励给核心团队（含研发团队、高管及销售人员等）的比例不低于 60%；每上一个台阶奖励一次，同一企业若满足多项条件，按照“从高不重复”原则支持。

申报类别 2

对年度销售收入首次突破 10 亿元、30 亿元、50 亿元、80 亿元、100 亿元、200 亿元的集成电路制造、封装测试类企业，分档给予企业最高 200 万元奖励，200 亿元以上每一个百亿元台阶增加奖励 100 万元。该条款按照我市现行高质量发展政策相应条款执行。

（七）支持企业兼并重组。

鼓励集成电路企业通过兼并、收购、参股等多种形式开展并购重组。对市场前景好、产业带动强、发展潜力大的重大项目，按照“一事一议”政策给予支持。对达到总部企业认定条件的新引进总部企业，参照对我市贡献给予连续 3 年每年 500 万元至 5000 万元等不同等次奖励。该条款按照我市现行高质量发展政策相应条款执行。

（八）支持企业上市。

对集成电路企业上市申请获证监会或交易所受理的，给予最高 300 万元奖励，获受理当年在科创板上市的企业再奖励 300 万元，在其他板上市的企业再奖励 100 万元。该条款按照我市现行高质量发展政策相应条款执行。

（九）支持链动发展。

申报类别 1

1.申报条件:

（1）销售额 1 亿元以上的集成电路、系统（整机）、终端等企业，或投资超 5 亿元项目的上述企业，采购本地非关联集成电路企业自主研发的芯片（模组按照芯片价格计价）、关键核心设备和材料；

（2）单个产品首次年度采购金额累计在 300 万元以上。

2.申报材料:

（1）采购补贴申报明细表（见附件 12）；

（2）经审计的年度企业财务审计报告、企业所得税年度纳税申报表等相关证明营收材料（按照销售额 1 亿元以上申请条件的企业提供）；项目备案表（按照投资超 5 亿元项目条件申请的企业提供）；

（3）采购合同、银行付款凭证、增值税发票等，其中设备需提供现场安装（安放）图片等证明材料；

（4）非关联关系（含母子公司）承诺，指定期限内的交易双方股权架构图。

3.支持方式:

按已支付实际采购金额 20% 给予采购方一次性补助，集成电路企业年度补助总额最高 1000 万元，系统（整机）、终端企业年度补助总额最高 300 万元。

申报类别 2

1. 申报条件:

(1) 集成电路产线（中试线）为省市主管部门认定的首台套装备、首批次新材料、新产品提供验证服务，验证单台（套）装备、单批次材料价格超过 50 万元；

(2) 首台套装备、首批次新材料、新产品等须通过省市主管部门认定。

2. 申报材料:

(1) 验证服务补贴申报明细表（见附件 13）；

(2) 省市主管部门认定首台套装备、首批次新材料、新产品相关文件证明材料；

(3) 企业开展装备和材料验证合同（协议），单台（套）装备、单批次材料价格超过 50 万元证明材料（企业采购同类型装备、材料的市场价格证明，提供采购合同、银行付款凭证、增值税发票等），新装备、新材料在产线（中试线）上验证的图片等证明材料。

3. 支持方式:

按照验证装备或材料价格 20%，分别给予提供验证方最高不超过 100 万元、50 万元补助。每家企业年度补助总额最高 300 万元。

(十) 支持公共平台建设。

申报类别 1

1. 申报条件:

(1) 获批建设国家“芯火”双创平台等国家级集成电路公共服务平台;

(2) 公共服务平台上一年度购置 EDA 软件、关键设备等。

2. 申报资料:

(1) 软件和设备补助申报明细表 (见附件 14);

(2) 获批国家“芯火”双创平台等国家级集成电路公共服务平台相关证明材料;

(3) 购置 EDA 软件、关键设备等详细列表 (包括功能、数量、用途等以及对应票据信息); 提供采购采购合同、银行付款凭证、增值税发票等, 其中设备需提供现场安装 (安放)、铭牌图片; 直接从境外购买的提供合同、形式发票、银行付款凭证、海关报关单及以上材料主要内容翻译成中文的相关材料。

3. 支持方式:

经认定, 按公共平台照购置 EDA 软件、关键设备等费用的 30%, 给予年度补助总额最高 1000 万元。

申报类别 2

1. 申报条件:

本地第三方技术服务或检测平台, 开展样片的功能、性能、可靠性、兼容性、失效分析等方面的测试验证及相关认证。

2. 申报材料:

(1) 服务本地企业奖励申报明细表（见附件 15）；

(2) 服务合同、银行付款凭证、增值税发票、年度专项审计报告等。

3.支持方式:

按公共服务平台实际服务本地企业费用（不含 EDA 租赁费用）的 10%给予奖励，年度奖励资金最高 200 万元。

（十一）支持设立投资基金。

依托市政府母基金设立相关集成电路产业子基金，集中支持集成电路重点企业发展、重大项目建设。支持基金参股国家产业基金、社会机构专业投资基金，放大基金规模。鼓励社会各类风险投资、股权投资基金、信保基金投资我市集成电路产业项目。该条款按照《合肥市促进股权投资发展加快打造科创资本中心若干政策》有关条款执行。

（十二）支持产业人才培育和引进。

支持行业组织、公共服务机构、高校院所、重点企业等单位牵头建设合肥市集成电路产教融合基地，开展集成电路人才技能培训、岗前实训等，按“一事一议”政策给予支持。对认定为集成电路企业产业人才的，按照我市人才政策可享受租房补贴、购房补贴、个税补贴、企业引才奖励、子女入学保障等支持政策。该条款按照我市现行人才政策有关条款执行。

四、监督管理

（一）资金申请单位对申报事项的真实性、合规性和资金使用负直接责任。

(二)县(市)区发改委、开发区经贸局等相关部门依据分工承担初审和资金的日常管理监督责任。

(三)咨询、设计、审计等中介机构对其编制的资金申报告、审计、评估等报告的真实性和公正性、独立性负责。

(四)企业、机构、团队(个人)应做到诚信申请。对违反国家、省及本市专项资金管理等有关规定,弄虚作假、骗取、套取财政资金,截留、挪用、转移或侵占奖补资金,擅自改变承诺实施事项等行为,视情况责令限期整改、停止拨付资金、限期收回已拨付的资金,同时按规定对项目单位和有关责任人进行处理,将项目单位及中介机构列入信用信息“黑名单”、取消3年内申请财政资金资格。对涉嫌犯罪的单位和个人,由司法机关依法追究其刑事责任。

本实施细则相关条款与市级其他政策同类型条款,按照从优不重复原则执行;已经享受市级“一事一议”政策同类型条款的,不再享受本实施细则同类型条款。

本实施细则自印发之日起施行,若遇国家、省市政策调整的,细则实施修订。补助(奖励)相关主体2021年1月1日至2023年12月31日期间符合条件的事项。国家和省有关法律、法规、文件规定与本实施细则不一致的,从其规定。

- 附件: 1.合肥市集成电路产业政策资金申请表
2.合肥市集成电路政策申请诚实信用承诺书
3.相关情况解释说明

- 4.流片补贴申报明细表
- 5.IP 补贴申报明细表
- 6.研发 IP 补贴申报明细表
- 7.购买或租用 EDA 补贴申报明细表
- 8.研发 EDA 补贴申报明细表
- 9.开发新产品奖励申报明细表
- 10.固定资产投资补贴申报明细表
- 11.企业成长壮大奖励申报明细表
- 12.采购补贴申报明细表
- 13.验证服务补贴申报明细表
- 14.软件和设备补助申报明细表
- 15.服务本地企业奖励申报明细表

附件 1

合肥市集成电路产业政策资金申请表

申报单位盖章

年 月 日

单位:万元

企业名称						
法定代表人		电 话		手机号码		
项目负责人		手机号码		统一社会信用代码		
开户银行		信用等级		帐 号		
主导产品						
上年度 财务状况	资产总额		负债总额		净资产总额	
	销售收入		工业总产值		出口创汇 (万美元)	
	净利润		上缴 税金总额		上缴所得税	
项目名称						
项目地址						
申请条款	1、	申请金额	1、			
	2、		2、			
			
企业缴纳 社保人数						
县(市)区、 开发区发改 (经贸)部门 审核结果	是否符合申报条件		县(市)区、开发区发改 (经贸)部门(盖章)			
	审核资金额					

合肥市集成电路政策申请诚实信用承诺书

合肥市发改委、合肥市财政局：

本单位本着诚实信用的原则郑重承诺：申报 年集成电路产业政策资金所报送的所有信息及材料均真实、准确、合规。如申报成功，保证资金使用合法合规。

如有不实之处，或违反相关规定，本单位愿意接受合肥市失信联合惩戒制度等相关规定的处理。

特此承诺。

单位名称（公章）

统一社会信用代码：

法人代表签字：

年 月 日

相关情况解释说明

一、企业类型判定

1.集成电路企业分为设计、制造、封装测试、设备材料、高端验证、工具软件(EDA)、IP 等领域,按其主营业务收入划分,原则上主营业务收入不低于该领域的 50%;

2.对营收低于 500 万元或没有营收的初创企业、研发型企业或新落户企业,可以结合企业主营开展业务、研发投入等综合判定。

二、关联交易说明

1.从项目执行期至政策申报当年,交易主体(含母子公司持股)之间存在股权关系,并且单方持股比例(或双方互相持股累计)超过 10%以上的,均判定为关联交易。

2.原则上不支持关联交易。确实需要开展关联交易并申请政策支持,企业需提供境内采购相关材料(可从性能需求、供给方性能对比、专家论证等方面提供),佐证关联交易必要性、合理性。

三、其它

涉及按票据补贴的事项,补助费用不含税费;在拨付资金前,企业需提供票据抵扣联,由所在地产业主管部门盖章确认,避免重复申报。

附件6

研发IP补贴申报明细表

附件6-1

研发人员信息及应税工资明细表

序号	申报单位名称	所属县区	统一社会信用代码	企业信用情况	研发人员姓名	岗位	在岗时间	学历	职称	年度应税工资合计(万元)	申请补贴金额(万元)	备注
合计												

备注：应税工资以个人所得税APP查询的纳税工资为准

附件6-2

其他研发费用明细表

序号	申报单位名称	所属县区	统一社会信用代码	企业信用情况	名称	规格型号	单价(万元)	金额(万元)	折旧年限/摊销比例	兑现期内的折旧金额/摊销费用	采购时间	来源(供应商名称)	发票编号(每张发票逐行列出)	发票时间	费用类别	申请补贴金额(万元)	备注
合计																	

